

### Lagenaufbau

| Ebene |  | Komponente  | Dicke (mm) | Cu (my) | Typ |
|-------|--|-------------|------------|---------|-----|
| 1     |  | Cu+galv.Cu  |            | 18+25   |     |
|       |  | HF Tr-Lam   | 0.25       |         |     |
| 2     |  | Cu          |            | 18      |     |
|       |  | FR4 Prepreg | 0.048      |         | 106 |
|       |  | FR4 Prepreg | 0.048      |         | 106 |
| 3     |  | Cu          |            | 18      |     |
|       |  | FR4 Tr-Lam  | 0.20       |         |     |
| 4     |  | Cu          |            | 18      |     |
|       |  | FR4 Prepreg | 0.048      |         | 106 |
|       |  | FR4 Prepreg | 0.048      |         | 106 |
| 5     |  | Cu          |            | 18      |     |
| 6     |  | HF Tr-Lam   | 0.25       |         |     |
|       |  | Cu+galv.Cu  |            | 18+25   |     |

Presslingsdicke \* 1,00 +/- 10%

Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske \* 1,11 +/- 10%

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe
- Mischaufbau - Verwindung / Wölbung > 0,75% möglich

### Designrules zum Lagenaufbau

|                                            |                                     |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Durchgangslöcher [A]<br>(Vias)             | End-Ø                               | ≥ 150 µm |
|                                            | Viapad-Ø                            | ≥ 450 µm |
| Sacklöcher [B]<br>(mechanical blind Vias)  | End-Ø                               | ≥ 400 µm |
|                                            | Viapad-Ø                            | ≥ 700 µm |
| Sacklöcher [C ]<br>(mechanical blind Vias) | End-Ø                               | ≥ 300 µm |
|                                            | Viapad-Ø                            | ≥ 600 µm |
| Leiterbild Außenlagen                      |                                     |          |
| Standard                                   | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer  | ≥ 100 µm |
|                                            | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 120 µm |
| Leiterbild Innenlagen                      |                                     |          |
| Standard                                   | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer  | ≥ 65 µm  |
|                                            | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 80 µm  |
|                                            | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer  | ≥ 85 µm  |
|                                            | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 100 µm |